

ブラシレスモータドライバの設計事例

試作 2 ～#1 実装組立～

基板実装、組立評価は、以下のフローで進めます。

- 実装部品の準備
- 評価計画の立案
- 評価治工具などの準備

例) MCU へのプログラム書込み治具



- 生板基板完成
- 部品実装組立へ払出し
- 基板組立完成
- 受け取り、チェック

⇒チェックでは、傷、瑕疵など無いかの目視検査

- ⇒テスターを用いての導通（オープン、ショート）検査
- ⇒電源を接続しての異常電流などないかの確認

事前に下記のチェックリストを作成しておき検査表に結果を記入します。

●デバッグ

- ⇒MCU にプログラムを書き込み、基本動作を確認



- #1 評価（評価計画で立案した内容に沿って測定評価を行う）
 - ⇒モータを接続しての本番評価を実施
 - ⇒温特（高温、低温）試験
 - ⇒信頼性試験（高温放置、バーンイン（連続通電）、TCT 試験）

●評価判定

- ⇒開発チーム内でレビューを行い、評価結果を報告。
- ⇒問題無ければ「合格」

●製品仕様書作成

- ⇒電気的特性保証項目の数値決め

●製品の発表、販売開始

